
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參見本文件「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使，且假設[編纂]為每股[編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]的中位數），我們預期從[編纂]中獲得的[編纂]淨額（扣除[編纂]、[編纂]及我們就[編纂]應付的預計開支後）將約為[編纂]港元。根據我們的策略，我們擬將[編纂][編纂]淨額用於以下用途：

- [編纂]%，或約[編纂]港元，將被分配用於我們第6代AMOLED生產線的技術升級。通過我們第6代AMOLED生產線的升級，我們能夠增強AMOLED顯示面板產品的技術先進性，增加其附加價值，提升我們的整體盈利能力，並進一步鞏固我們在市場中的先進地位。具體如下：
 - (i) [編纂]%，或約[編纂]港元，將用於採購新生產設備，其中[編纂]港元、[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元將分別於2026年、2027年、2028年及2029年使用，以分別將柔性面板及封裝觸控面板（「TOE」）的陣列生產線產能每月增加7,500大板，並實現封裝彩色濾光片（「COE」）技術的製程能力，包括與該等設備相關的安裝調試費用以及物流費用。我們計劃於2026年開始採購相關設備。2026年，我們將採購約13台至17台有關柔性面板及COE及TOE面板陣列生產線的主要設備及若干附屬設備。2027年，我們將採購約4台至10台有關柔性面板及TOE面板陣列生產線的主要設備及若干附屬設備。2028年，我們將採購約1台至2台有關柔性面板及COE及TOE面板陣列生產線的主要設備及若干附屬設備。2029年，我們將完成設備驗收，結清未償還餘額。為實現上述技術升級而採購的設備主要包括曝光機、等離子化學氣相沉積設備、聚酰亞胺固化爐及其他設備；

未來計劃及[編纂]用途

- (ii) [編纂]%，即約[編纂]港元，將用於採購新生產設備，其中[編纂]港元、[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元將分別於2026年、2027年、2028年及2029年使用，以擴大薄膜封裝的生產能力7,500大板/月，包括與該等設備相關的安裝調試費用以及物流費用。我們計劃於2027年開始採購相關設備。於2027年、2028年及2029年，我們將分別採購約1台至5台、9台至12台及1台至4台與擴充薄膜封裝產能相關的主要設備及若干附屬設備。於2029年，我們將完成設備驗收，結清未償還餘額。為實現上述技術升級而採購的設備主要包括等離子化學氣相沉積設備、噴墨打印機、填孔機及其他設備；及
- (iii) [編纂]%，或約[編纂]港元，將用於採購新生產設備，其中[編纂]港元、[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元將分別於2026年、2027年、2028年及2029年使用，以加強模組工藝的生產能力，包括將柔性面板切割階段的產能每月增加7,500大板，以及將Hybrid面板切割階段的產能每月增加5,000大板，以及增加每月120,000片的柔性模組產能，包括與該等設備相關的安裝調試費用以及物流費用。我們計劃於2026年開始採購相關設備。於2026年，我們將採購約1台至5台與提高柔性及Hybrid面板切割的產能相關的主要設備及若干附屬設備。於2027年，我們將採購約17台至21台與提高柔性模組及柔性面板切割的產能相關的主要設備及若干附屬設備。於2028年，我們將採購約1台至2台與提高柔性模組以及柔性面板切割的產能相關的主要設備及若干附屬設備。於2028年及2029年，我們將逐步完成設備驗收，結清未償還餘額。為實現上述技術升級而採購的設備主要包括全模組柔性線、激光切割機、自動判片機及其他設備。
- [編纂]%，或約[編纂]港元，將被分配用於新型AMOLED顯示面板產品的研發，主要包括就設備治具、人員薪金及其他研發投資相關的付款。為緊跟技術發展步伐及滿足市場需求，我們計劃開發約33至44款新的AMOLED半導體顯示產品，其中[編纂]港元、[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元將分別於2026年、2027年、2028年及2029年使用，包括：(i)[編纂]%，或約[編纂]港元，將被分配用於專為平板/筆記本電腦設計的約15至19種不同尺寸和規格的產品；(ii)[編纂]%，或約[編纂]港元，將被分配用於專為智能手機設計的14到19種不同尺寸和規格的產品；及(iii)[編纂]%，或約[編纂]港元，將被分配用於專為車載顯示和其他應用設計的約4至6種不同尺寸和規格的產品。於2026年，我們計劃開發7至11款新產品，主要針對中高端及旗艦手機及平板的AMOLED半導體顯示面板。於2027年及2028年，我們計劃分別開發10至14款和10至12款新產

未來計劃及[編纂]用途

品。除上述於2026年開發的產品外，我們將投入摺疊式手機、中高端及旗艦筆記本電腦以及車載顯示產品的AMOLED半導體顯示面板開發。於2029年，我們計劃開發6至7款新產品，主要針對中高端及旗艦手機、中高端平板/筆記本電腦、旗艦筆記本電腦及車載顯示產品的AMOLED半導體顯示面板。

該等產品將融入我們一種或多種更先進的技術，主要包括更先進的疊層OLED技術、Hybrid設計技術及LTPO技術，所有該等技術將大幅提升AMOLED顯示面板產品的品質。具體而言，疊層OLED顯示技術可實現顯示面板在亮度、效率和壽命方面的指數級增長。我們的Hybrid AMOLED是一種產品結構，利用薄膜封裝技術取代了蓋板玻璃，使其兼具剛性屏和柔性屏的優勢，與剛性玻璃顯示技術相比，厚度更薄、重量更輕，同時相比柔性屏具有成本優勢。與此同時，LTPO技術可實現AMOLED半導體顯示產品低功耗和高響應速度的特性。我們將繼續推動新技術的快速應用，提供性能更佳、附加值更高的產品，從而鞏固行業先進地位。

- [編纂]%，或約[編纂]港元，將被分配用於償還我們的部分計息銀行借款及其他借款。截至2025年9月30日，我們的計息銀行借款及其他借款金額達人民幣17,202.0百萬元，這些借款主要用於支持我們的業務運營及產品生產。這些借款的利率為每年不超過3.2%，借款到期日範圍從2年到10年。我們計劃使用[編纂]淨額來推進還款計劃，並儘量降低整體財務成本，從而優化我們的資本結構；及
- [編纂]%，或約[編纂]港元，將被分配用於我們的營運資金及一般公司用途。

若[編纂]最終確定高於或低於本文件所述指示性[編纂]的中位數，上述[編纂][編纂]淨額的分配將按比例作出調整。

我們估計，在扣除[編纂]、[編纂]以及我們就[編纂]應付的預計開支後，且假設[編纂]未獲行使，[編纂]為每股[編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]的中位數）的情況下，我們將從[編纂]中獲得約[編纂]港元的[編纂]淨額。若[編纂]定為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]的上限），[編纂][編纂]淨額將增加約[編纂]港元。若[編纂]定為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]的下限），[編纂][編纂]淨額將減少約[編纂]港元。若[編纂]獲悉數行使，且假設[編纂]為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]的中位數），我們將額外獲得的[編纂]淨額約為[編纂]港元。

未來計劃及[編纂]用途

在符合本公司最佳利益的情況下，我們會將[編纂][編纂]淨額中暫時無需用於上述用途的部分，存放於持牌商業銀行及/或《證券及期貨條例》或其他司法管轄區適用法律法規所界定的獲認可金融機構的短期有息賬戶內。在此情況下，我們將遵守《上市規則》下的相關披露規定。

根據我們上述戰略步驟，我們計劃按下列用途及金額動用[編纂]：

	截至12月31日止年度				總計 (百萬 港元)	佔[編纂] 總額的概約 百分比
	2026年	2027年	2028年	2029年		
我們第6代AMOLED生產線的技術升級	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
增加柔性面板及封裝觸控(「TOE」)面板的 陣列生產線產能	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴大薄膜封裝的生產能力	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
加強模組工藝的生產能力	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
新型AMOLED半導體顯示產品的研發	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
專為平板/筆記本電腦設計約15至19種不 同尺寸規格的產品	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
專為智能手機設計約14至19種不同尺寸規 格的產品	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
專為車載顯示及其他應用設計六種不同尺 寸規格的產品	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
償還部分計息銀行借款及其他借款	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
營運資金及一般公司用途	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]